

台灣發明協會 函

地址：241608新北市三重區重陽路一段1號
4樓之11

承辦人：吳秋瑾

電話：02-66057626

電子信箱：tia7626@yahoo.com.tw

受文者：屏東縣立大同高級中學

發文日期：中華民國113年6月24日

發文字號：台發協字第1130006006號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：韓國首爾國際發明展簡章 (0006006A00_ATTCH3.pdf、0006006A00_ATTCH4.doc、
0006006A00_ATTCH5.doc)

主旨：敬邀 貴校師生參加「2024SIIF韓國首爾國際發明展」。

說明：

一、台灣發明協會 Taiwan Invention Association，深耕國際發明圈52載，為世界各大著名發明展籌組台灣代表團參展，台灣代表團所展出之成績斐然，獲獎甚多，拓展之商機無限。

二、2024 SIIF韓國首爾國際發明展，是經濟部智慧財產局公告著名國際發明展之一，為亞洲最大發明展，敬邀貴校師生參與國際發明競賽，請惠予公告並鼓勵相關人員踴躍參加。

三、參展日期、地點：113年11月27日~11月30日，韓國首爾世貿
COEX展覽館展出，共為期4天

四、即日起報名至113年9月30日止，洽詢專線02-6605-7626吳秘書或email：tia7626@yahoo.com.tw或LINE ID:@123atruj

五、早鳥報名補助「香港創新發明展」參展費。

正本：基隆市立中山高級中學、基隆市立安樂高級中學、基隆市立暖暖高級中學、二信學校財團法人基隆市二信高級中學、輔仁大學學校財團法人基隆市輔大聖心高級中學、國立基隆女子高級中學、國立基隆高級中學、臺北市立大同高級中學、臺北市立大直高級中學、臺北市立大理高級中學、臺北市立中山女子高級中學、臺北市立中正高級中學、臺北市立中崙高級中學、臺北市立內湖高級中學、臺北市

立第一女子高級中學、臺北市立永春高級中學、臺北市立成功高級中學、臺北市立西松高級中學、臺北市立和平高級中學、臺北市立育成高級中學、臺北市立松山高級中學、臺北市立南港高級中學、臺北市立南湖高級中學、臺北市立華江高級中學、臺北市立陽明高級中學、臺北市立景美女子高級中學、臺北市立復興高級中學、臺北市立萬芳高級中學、臺北市立麗山高級中學、幼華學校財團法人臺北市幼華高級中等學校、臺北市私立大同高級中學、臺北市私立大誠高級中學、臺北市私立文德女子高級中學、臺北市私立方濟高級中學、臺北市私立再興高級中學、臺北市私立東山高級中學、臺北市私立延平高級中學、臺北市私立金甌女子高級中學、臺北市私立泰北高級中學、韻鏗學校財團法人臺北市協和祐德高級中等學校、臺北市私立強恕高級中學、臺北市私立景文高級中學、華興學校財團法人臺北市私立華興高級中等學校、臺北市私立滬江高級中學、臺北市私立衛理女子高級中學、財團法人臺北市私立靜修高級中學、臺北市私立靜修高級中學、臺北市私立薇閣高級中學、國立臺灣師範大學附屬高級中學、國立高雄師範大學附屬高級中學、天主教光仁學校財團法人新北市光仁高級中學、新北市私立竹林高級中學、東海中學學校財團法人新北市東海高級中學、金陵學校財團法人新北市金陵女子高級中學、南山學校財團法人新北市南山高級中學、剛恆毅學校財團法人新北市天主教恆毅高級中學、鄭義燕學校財團法人新北市私立格致高級中等學校、新北市私立徐匯高級中學、天主教崇光學校財團法人新北市崇光高級中學、新北市私立淡江高級中學、崇義學校財團法人新北市崇義高級中學、天主教聖功學校財團法人臺南市天主教聖功女子高級中學、新北市私立醒吾高級中學、辭修學校財團法人新北市私立辭修高級中學、新北市立三重高級中學、新北市立中和高級中學、新北市立林口高級中學、新北市立板橋高級中學、新北市立泰山高級中學、國立華僑高級中等學校、新北市立新店高級中學、新北市立新莊高級中學、新北市立三民高級中學、新北市立永平高級中學、新北市立石碇高級中學、新北市立安康高級中學、新北市立秀峰高級中學、新北市立金山高級中學、新北市立明德高級中學、新北市立海山高級中學、新北市立清水高級中學、新北市立樹林高級中學、新北市立錦和高級中學、新北市立雙溪高級中學、臺灣大華學校財團法人桃園市私立大華高級中等學校、大興學校財團法人桃園市大興高級中等學校、六和學校財團法人桃園市六和高級中等學校、光啟學校財團法人桃園市光啟高級中等學校、至善學校財團法人桃園市至善高級中等學校、桃園育達學校財團法人桃園市育達高級中等學校、治平學校財團法人桃園市治平高級中等學校、天主教振聲學校財團法人桃園市振聲高級中等學校、啟英學校財團法人桃園市啟英高級中等學校、復旦學校財團法人桃園市復旦高級中等學校、新興學校財團法人桃園市新興高級中等學校、國立中央大學附屬中壢高級中學、桃園市立內壢高級中等學校、桃園市立武陵高級中等學校、桃園市立桃園高級中等學校、桃園市立陽明高級中等學校、桃園市立楊梅高級中等學校、桃園市立永豐高級中等學校、桃園市立平鎮高級中等學校、新竹市立成德高級中學、新竹市立香山高級中學、新竹市立建功高級中學、新竹市世界高級中學、新北市立光復高級中學、新竹市私立光復高級中學、新竹市私立磐石高級中學、新竹市私立曙光女子高級中學、國立新竹科學園區實驗高級中等學校、國立新竹女子高級中學、國立新竹高級中學、新竹縣仰德高級中學、新竹縣私立忠信高級中學、臺灣省新竹縣私立東泰高級中學、新竹縣私立義民高級中學、國立竹北高級中學、國立竹東高級中學、新竹縣立湖口高級中學、苗栗縣私立大成高級中學、苗栗縣私立君毅高級中學、苗栗縣私立建臺高級中學、國立竹南高級中學、國立卓蘭高級中等學校、國立苗栗高級中學、國立苑裡高級中學、苗栗縣立興華高級中學、臺中市立大甲高級中等學校、國立中科實驗高級中學、臺中市立中港高級中學、臺中市立文華高級中等學校、臺中市立大里高級中學、臺中市私立弘文高級中學、臺中市私立玉



山高級中學、臺中市私立立人高級中學、臺中市立后綜高級中學、臺中市立西苑高級中學、宜寧學校財團法人臺中市宜寧高級中學、臺中市立忠明高級中學、臺中市明台高級中學、臺中市私立明道高級中學、明德學校財團法人臺中市明德高級中學、財團法人東海大學附屬高級中等學校、臺中市立東山高級中學、臺中市立長億高級中學、臺中市青年高級中學、臺中市私立致用高級中學、國立中興大學附屬高級中學、常春藤學校財團法人臺中市常春藤高級中學、臺中市立清水高級中等學校、臺中市立惠文高級中學、臺中市華盛頓高級中學、臺中市私立慈明高級中學、臺中市私立新民高級中學、臺中市立新社高級中學、葳格學校財團法人臺中市葳格高級中學、臺中市私立僑泰高級中學、嘉陽學校財團法人臺中市嘉陽高級中學、臺中市立臺中第一高級中等學校、臺中市立臺中第二高級中等學校、臺中市立臺中女子高級中等學校、臺中市私立衛道高級中學、臺中市私立曉明女子高級中學、臺中市私立嶺東高級中學、臺中市立豐原高級中等學校、南投縣私立五育高級中學、國立中興高級中學、國立竹山高級中學、國立南投高級中學、國立暨南國際大學附屬高級中學、南投縣立旭光高級中學、彰化縣私立文興高級中學、正德學校財團法人彰化縣正德高級中學、彰化縣私立精誠高級中學、國立員林高級中學、國立鹿港高級中學、國立溪湖高級中學、國立彰化女子高級中學、國立彰化高級中學、彰化縣立二林高級中學、雲林縣私立文生高級中學、雲林縣私立正心高級中學、雲林縣私立永年高級中學、雲林縣私立巨人高級中學、揚子學校財團法人雲林縣揚子高級中等學校、義峰學校財團法人雲林縣義峰高級中學、國立斗六高級中學、國立北港高級中學、國立虎尾高級中學、雲林縣立斗南高級中學、雲林縣立麥寮高級中學、嘉義市私立仁義高級中學、嘉義市私立輔仁高級中學、嘉義市私立嘉華高級中學、嘉義市私立興華高級中學、國立嘉義女子高級中學、國立嘉義高級中學、嘉義縣私立同濟高級中學、嘉義縣私立協同高級中學、嘉義縣私立協志高級工商職業學校、國立東石高級中學、臺南市六信高級中學、臺南光華學校財團法人臺南市光華高級中學、臺南市私立長榮女子高級中學、臺南市私立長榮高級中學、臺南市德光高級中學、臺南市私立瀛海高級中學、國立臺南第一高級中學、國立臺南第二高級中學、國立臺南女子高級中學、國立臺南家齊高級中等學校、臺南市私立明達高級中學、臺南市私立南光高級中學、臺南市私立港明高級中學、臺南市私立新榮高級中學、方濟會學校財團法人臺南市黎明高級中學、興國學校財團法人臺南市興國高級中學、國立北門高級中學、國立後壁高級中學、國立善化高級中學、國立新化高級中學、國立新營高級中學、國立新豐高級中學、臺南市立大灣高級中學、高雄市立三民高級中學、高雄市立小港高級中學、高雄市立中山高級中學、高雄市立中正高級中學、高雄市立左營高級中學、高雄市立前鎮高級中學、高雄市立高雄女子高級中學、高雄市立高雄高級中學、高雄市立鼓山高級中學、高雄市立新莊高級中學、高雄市立瑞祥高級中學、高雄市立新興高級中學、高雄市私立大榮高級中學、立志學校財團法人高雄市立志高級中學、天主教明誠學校財團法人高雄市明誠高級中學、國立中山大學附屬國光高級中學、高雄市私立復華高級中學、天主教道明學校財團法人高雄市道明高級中學、中正國防幹部預備學校、高雄市私立正義高級中學、佛光山學校財團法人高雄市普門高級中學、新光學校財團法人高雄市新光高級中學、國立鳳山高級中學、國立岡山高級中學、國立旗美高級中學、國立鳳新高級中學、高雄市立文山高級中學、高雄市立仁武高級中學、高雄市立六龜高級中學、高雄市立林園高級中學、高雄市立路竹高級中學、高雄市立福誠高級中學、屏東縣私立美和高級中學、陸興學校財團法人屏東縣陸興高級中學、國立屏東女子高級中學、國立屏東高級中學、國立潮州高級中學、屏東縣立大同高級中學、屏東縣立來義高級中學、屏東縣立枋寮高級中學、中道學校財團法人宜蘭縣中道高級中學、宜蘭縣私立慧燈高級中學、國立宜蘭高級中學、國立羅東高級中

裝

訂

線



學、國立蘭陽女子高級中學、四維學校財團法人花蓮縣四維高級中學、花蓮縣私立海星高級中學、花蓮縣立體育高級中等學校、國立玉里高級中學、國立花蓮女子高級中學、國立花蓮高級中學、慈濟學校財團法人慈濟大學附屬高級中學、未來學校財團法人臺東縣私立育仁高級中學會計室、國立臺東女子高級中學、國立臺東高級中學、國立臺東大學附屬體育高級中學、臺東縣立蘭嶼高級中學、國立金門高級中學、國立馬祖高級中學、國立馬公高級中學、國立東華大學、中華台北著作權人協會

副本：



張家菊 會長

裝

訂

線



2024 第 20 屆韓國首爾國際發明展 台灣參展團



Seoul International Invention Fair 2024

邀 請 函

發明先進：敬啟

發明界的新興市場，第廿屆韓國首爾國際發明展即將開鑼，本會繼上屆優良成果，繼續組團參加。

韓國市場為台灣的二倍，上屆有來自 19 個國家，近 500 件作品參展，是一個地理相近又可相互砥礪吸取經驗的展覽，千萬不要錯失這一年一度的盛會，本會與全體工作人員誠摯的邀請，同時亦期望您的作品可在一夕間舉世聞名，又可觀摩世界各國發明人的新作品，以予學習改進參考。

今年我們除了傳承以往的優點外，特別報告如下：

您的作品若擁有台灣專利(展前四年內取得)參展獲金、銀、銅牌之獎項，可得經濟部智慧財產局之機票部份補助。(詳見內頁獎助辦法說明)

展出日期：2024 年 11 月 27 日-11 月 30 日

即日起接受報名至 9 月 30 日截止



台灣發明協會

團長 **張家菊** 敬邀

2024 韓國首爾第 20 屆國際發明展-參展辦法

- 一、宗旨：為宣揚我國工業技術能力，促進國際科技交流，爭取國家榮譽，增進國民外交，拓展發明新產品海外市場，提高新產品之行銷市場價值，特制定本參展辦法。
- 二、主辦單位：Korea Invention Promotion Association (KIPA)
- 三、台灣授權單位：台灣發明協會
- 四、團名：2024 韓國首爾國際發明展-台灣參展團
- 五、依據：韓國首爾國際發明展覽大會授權書
- 六、展出日期：2024 年 11 月 27 日至 11 月 30 日
- 七、展出地點：韓國首爾世貿展覽館 Exhibition Hall C, COEX
COEX, 513, Yeongdong-daero, Gangnam-gu, Seoul 06164, Korea
- 八、參展作品：凡有前往參展之作品有台灣專利證書者(展前四年內取得)，一但得獎，經濟部智慧財產局將補助部份機票費，以茲鼓勵。
註：若無台灣專利證書也可參展但無補助。
- 九、參展費用：

1. 國內報名費 **新台幣 5,000 元** (限同參展人或同單位)

2. 攤位費：

攤位面積 $3^m \times 3^m \times 2.4^m$ ，每攤 **新台幣 51,000 元**

(一個攤位可展三件作品，限同參展人或同單位)

3. 專刊、海報費用 **新台幣 4,000 元/件**。(統一製作)

4. 其他費用：

①隨團個人旅費：**新台幣 42,800 元** (不含機票)

(請自行轉付旅行社) (刷卡需另+2%手續費)

(國際機票浮動大，建議提早自行訂購或洽本會配合之旅行社訂購。)

②參展品運送費用另計。(詳洽 裕航空運 翁小姐 02-2777-1620#28)

③展覽會場之另加租桌椅...等其他費用另計。

十、即日起接受報名至 9 月 30 日截止

※ 截止日前資料未繳交齊全者將無法於韓國展覽大會專刊裡刊登。

※ 指定轉角攤位者須另加台幣 10,000 元。(有預訂並繳款者優先選位)

※ 素食者或需住單人房(另加台幣 16,000 元)也請於隨團報名表裡註明。

※ 每攤位含一桌一椅(展桌尺寸：長 100 寬 50 高 75 公分)。

電源插座(220V, 60Hz, 1kw)。



繳交參展資料明細單：

以下資料請以電子檔交件：tia7626@yahoo.com.tw

寄件主旨請輸入 xxx(個人名、學校名或公司名)報名韓展。

文字部份請交 **word** 檔，照片圖檔請以 **jpg** 檔交件，繳交其他檔案格式歉難受理作業，每件作品請獨自建立一資料夾，報名一件以上之作品，請於資料夾上輸入編號，以便通知補件作業，謝謝。

- 1. 已填妥之報名表(一件作品填寫一份報名表，需詳細填寫完整)
- 2. 切結書(請由一位發明人代表簽名或蓋章)
- 3. 參展品台灣專利證書掃描檔案(或專利申請中收據)
(無專利者免附。有專利卻未檢附者，歉難申請經濟部機票補助)
- 4. 參展品照片檔案(每件作品建議提供二張)
- 5. 隨本團前往參展人員請附上隨團報名表(含護照影本)
- 6. 自行前往參展人請提供個人中英文姓名，以便申請參展識別證。
- 7. 發明人或聯絡人名片一張

報名日期：即日起接受報名至 9月30日截止

聯絡人：秘書處 吳秋瑾 小姐

聯絡電話：02-6605-7626

E-mail：tia7626@yahoo.com.tw

聯絡地址：(241-608)新北市三重區重陽路一段1號4樓之11



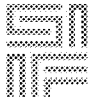
台灣發明協會
官方好友 LINE

• 以上資料請於報名截止日前，連同訂金 **20,000元/攤位**，繳交至本會，以順利完成報名手續。

• 電匯資料：新光銀行(銀行代碼 103) 北三重分行

戶名：**台灣發明協會**

帳號：**0310-10-100304-3**



2024 韓國首爾國際發明展參展報名表

發明人姓名 請勿修改表格 請勿修改表格 請勿修改表格	發明人填寫姓名注意事項：發明人姓名為若得獎獎狀上的得獎名稱，一位以上之發明人，請一律填寫於欄位內，資料一旦送出，不得變更更改。(含若得獎的得獎證書)		
	(中+英) 範例：王小明 Wang Hsiao-Ming		
公司/學校名稱	(中)	統一編號	
	(英)		
聯絡地址	(中) □□□-□□		
	(英)		
電話		手機	
E-mail			
http://			
聯絡人	姓名：	職稱：	參展品類別 請參閱下頁選項 填入一類別編號
	電話：		
	E-mail:		
台灣專利	<input type="checkbox"/> 發明_____號 <input type="checkbox"/> 新型_____號 <input type="checkbox"/> 設計_____號		
專利名稱			
	<input type="checkbox"/> 公告中案號_____號 <input type="checkbox"/> 申請中案號_____號		
作品名稱	(中文)		
	(英文)		
作品介紹	產品介紹(中英文簡要說明各約 100 字) (作品照片請另檢附 JPG 檔，勿貼在此報名表內。)		

(以上所有欄位請確實詳細填寫後再次確認檢查，報名表送出後不得變更及修改內容。)

CLASS - CHECK THE CATEGORY OF YOUR INVENTION (產品種類)

A	Mechanics(機械學) / Engines(引擎) / Machinery(機械) / Tools(工具) / Industrial process(工業生產流程) / Metallurgy(冶金學)
B	Computer science(電腦科學) / Software(軟體) / Electronics(電子) / Electricity Methods of Communication(電力通信方法)
C	Building(建築) / Architecture(建築學) / Civil Engineering(土木工程) / Construction(建造) / Materials(材料) / Woodwork(木工)
D	Sanitation(公共、環境衛生) / Ventilation(通風設施) / Heating(暖氣)
E	Security(安全) / Rescue(救援) / Alarm(警報裝置)
F	House-keeping and nutrition(家務管理及營養學)
G	Commercial, Industrial, and Office equipment(商業、工業以及辦公室的設備)
H	Agriculture(農業) / Forestry and Garden(林業及園藝) / Pet and Farm animal supplies(寵物及家畜相關產品)
I	Traffic(交通) / Transport(運輸) / Car accessories(汽車用品)
J	Medical Technology(醫學科技) / Medicine(藥品) / Hygiene(衛生) / Cosmetics(美容、化妝品)
K	Graphic arts(平面藝術) / Advertising(廣告)
L	Teaching research and pedagogical items(教學研究及教學項目)
M	Games(遊戲) / Sport(運動) / Hobby(嗜好)
N	Information technology(資訊科技)
O	Environmental protection(環境保護)
P	Other inventions and new practical products(其他類發明品及新型實用產品)

切 結 書

※每件作品請一位發明人代表填寫一份切結書，請簽名或用印後掃描回傳。

本人參加 2024 韓國首爾國際發明展，其參展報名表填寫之所有內容，皆已再次確認無誤，同意報名表送出後，不得再做任何修改及變更，含若得獎的得獎證書亦同。

同時願意遵守大會一切規定，並絕對尊重大會國際裁判的評審結果，絕無異議。

立書人

姓 名： (簽/蓋章)

公司/學校：

身分證字號：

住 址：

電 話：

作品名稱：

中華民國 113 年 月 日